捲帶式晶粒自動接合構裝製程
的材料溫度分佈

Distribution of Material Temperature in the Tape-Automated-Bonding Packaging Process

研 究 生: 李 兆 楨 Student : Chao-Chen Lee

指導教授: 陳 仁 浩 Advisor : Ren-Haw Chen

國 立 交 通 大 學

工學院精密與自動化工程學程

碩 士 論 文

A Thesis

Submitted to Degree Program of Automation and Precision Engineering

College of Engineering

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Science

in

Automation and Precision Engineering

June 2005

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國 九十四 年 六 月